

上海天承科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例

每 10 股派发现金红利 1.406 元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

- 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形（适用于年度分红方案）。

- 本次利润分配预案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 86,679,137.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 68,108,000.19 元。公司 2025

年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.406 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 124,724,524 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 438,802 股后的股本数为 124,285,722 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,474,572.51 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 17,474,572.51 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0.00 元，现金分红和回购金额合计 17,474,572.51 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 20.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 17,474,572.51 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 20.16%。

2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份 438,802 股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案在董事会审议通过后提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下表所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	17,474,572.51	24,959,590.80	19,508,645.80
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,679,137.43	74,679,913.48	58,572,302.56
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	68,108,000.19		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	61,942,809.11
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	73,310,451.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	61,942,809.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3000 万元	否
现金分红比例（%）	84.49
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	84,701,728.98
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,190,564,701.97
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	7.11
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 86,679,137.43 元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，当年采用集中竞价方式、要约方式当年已实施的股份回购金额）为 17,474,572.51 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务为电子电路专用电子化学品的研发、生产和销售，所属细分行业为电子专用材料制造中的“功能性湿电子化学品”。功能性湿电子化学品行业具有极高的技术与经验壁垒，其配方开发不仅涉及电化学、材料学等多学科的深度交叉，还需紧密贴合高端 PCB、封装载板及半导体先进封装在新型材料与复杂

结构上的严苛演进需求，并高度依赖长期的产线应用测试以沉淀核心工艺参数。目前，该高端市场长期由具备先发优势的外资品牌主导。然而，在全球集成电路、AI 算力等产业加速向国内转移的背景下，基于供应链安全与降本增效考量，高端原材料的国产替代需求愈发迫切。面对深厚的技术门槛与重大的进口替代机遇，国内企业必须持续投入大量资金用于底层配方攻坚与应用经验积累，方能打破外资主导格局并抢占市场先机。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内印制电路板高端湿电子化学品领域的资深供应商。该领域属于典型的技术密集型产业，国内市场长期由外资品牌占据主导地位。近年来，公司通过持续的配方积累与底层技术研发，在多个核心产品上实现了国产替代，逐步提升了国内产品的市场份额与客户认可度。

当前，在 AI 算力爆发及高性能计算的驱动下，下游客户对高端 PCB 及半导体封装材料的性能要求日益严苛，对供应链自主可控的需求也愈发迫切。为应对上述产业趋势与市场需求，公司必须保持较高的资金投入，为核心技术攻坚、配套产能建设、专业人才引进及市场拓展提供坚实的资金保障，从而稳步提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2025 年度，公司实现营业收入为 470,964,851.77 元，同比增长 23.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 86,679,137.43 元，同比增长 16.07%，公司盈利状况稳定。为保障公司中长期可持续发展，公司仍需储备充足的流动资金，以满足公司持续研发投入及业务规模扩大的需求，增强公司的行业地位和竞争优势，为投资者创造更长远、稳定的投资回报。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

为应对日益激烈的市场竞争并保障经营目标的顺利实现，公司在 2026 年度需于技术研发、产能扩建、市场拓展及产业整合等关键环节保持充足的资金投入。具体而言，公司将持续加大研发力度，重点攻坚印制电路板高端湿电子化学品关键技术，并加速布局集成电路及泛半导体材料等新业务领域；同时，为巩固国内优势并紧跟产业链趋势开拓国际市场，公司将全面提速海外生产基地建设，并进一步完善全球化营销网络。此外，随着业务规模的稳步扩张，日常采购、生产及管理等环节的营运资金需求将相应增加；结合产业发展趋势，公司将密切关注产业链上下游的优质资源整合机会，适时探索多元化的战略协同路径，持续为公司培育新的价值增长点。未来，公司将严格规范资金使用管理，切实提高资金使用效率，持续优化盈利结构与核心盈利能力；并在统筹战略发展需求的基础上，逐步完善长效回报机制，致力于为投资者创造更大价值，带来长期、持续的丰厚回报。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

1、公司将在年度报告披露后至年度股东会股权登记日期间，通过召开线上业绩说明会，就本次现金分红方案向投资者作重点说明。

2、公司将采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。在审议现金分红方案时，将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以披露，切实保障中小股东参与决策的权利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续加大研发投入，攻坚印制电路板高端湿电子化学品关键技术，巩固并增强公司产品与服务的综合竞争优势；同时，积极探索集成电路及泛半导体材料等新业务领域，培育新的利润增长点，持续提升公司盈利能力。公司也将重

视市值管理和投资者关系管理等工作，积极履行具有连续性和稳定性的利润分配政策，从当前与长远两个方面兼顾股东利益与公司长远发展。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交至公司 2025 年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日